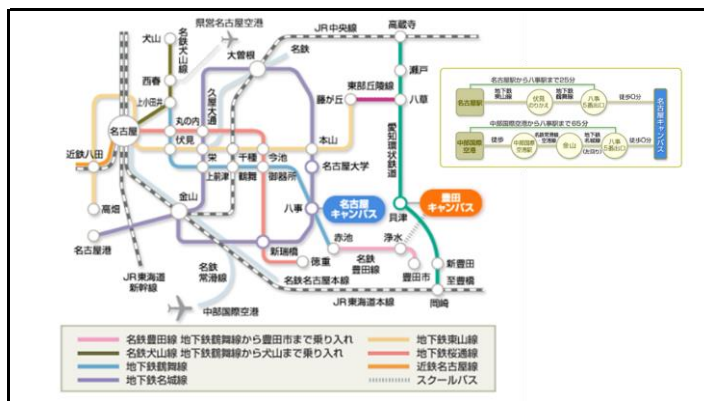
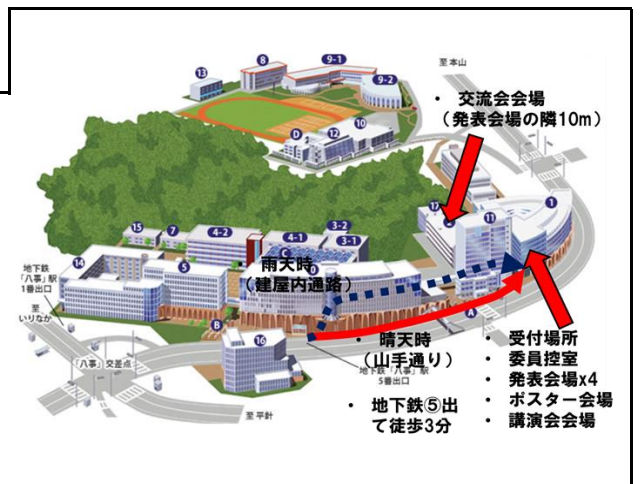


MES2016 プログラム			9月8日(木)	
	A会場	B会場	C会場	D会場
9:50	【1A1】パワーエレクトロニクス-1 1. パワーエレクトロニクスを支えるパワー半導体モジュール技術の最新動向 ○高橋良和, 両角朗, 西村芳孝(富士電機) (依頼講演 40分) 2. パワーモジュールの高信頼性化に向けたCuコネクタ接続手法の検討 ○川城史義 ^{1,2} , 小林達也 ¹ , 吉川雅章 ¹ , 遠藤佳紀 ¹ , 刀福館達郎 ¹ , 西川宏 ¹ (¹ 東芝, ² 大阪大学) 3. トロイダル型チョークコイルの熱シミュレーションモデル ○壁谷真人 ¹ , 梶田欣 ² , 岩間由希 ³ , 齊藤幸弘 ³ , 衛藤潤 ¹ , 飯嶋保男 ⁵ , 小澤孝充 ¹ (¹ 豊田自動織機, ² 名古屋工業大学, ³ オムロンオートモーティブエレクトロニクス, ⁴ ソフトウェアクリエイトル, ⁵ 構造計画研究所) 4. グラファイト/SiN積層放熱板を用いた実装構造の信頼性評価 ○三浦大貴 ¹ , 柳瀬匡史 ¹ , 山田靖 ¹ , 竹馬克洋 ² (¹ 大同大学, ² サーマグラフィティクス) 5. パワーデバイス樹脂パッケージの吸湿信頼性解析 ○小松拓, 権藤聡, 田中宏之(住ベリサーチ)	【1B1】表面処理・めっき技術-1 1. 化学的材料表面制御に基づく高機能性インプラント作製の試みと工業的応用 ○黒田健介(名古屋大学) (依頼講演 40分) 2. 無電解Ni-Pめっき銅配線の耐析性およびばね鋼塗層類、Niめっき結晶構造および膜厚の影響 ○亀井勝, 渋谷宏明, 珍田聡(JX金属商事) 3. ファインパターンに対応した無電解Ni-Pめっき ○瀬戸寛生, 村田俊也(奥野製薬工業) 4. 無電解Ni/Pd/Auめっきにおけるはんだボール接続信頼性 - 無電解Pdめっき皮膜のリン濃度および膜厚の影響 - ○江尻芳則 ¹ , 櫻井健久 ¹ , 荒山貴博 ² , 坪松良明 ¹ , 長谷川清 ¹ (¹ 日立化成, ² 日立化成テクノサービス) 5. ENEPIGめっき皮膜のエレクトロマイグレーション評価 ○笹村哲也, 古矢絵理子, 田邊克久, 小田幸典, 橋本滋雄(上村工業)	【1C1】先端インターコネクト・接合技術 1. レーザはんだ付したSn-Ag-Cu-Ni/Cu界面における金属間化合物形成とその成長 ○松延誠, 西川宏(大阪大学) 2. 加熱超音波ブリッジ接合による銅接合、はんだ接合の形成 ○石川隆隆, 小塩哲平(パナソニックファクトリーソリューションズ) 3. 紫外領域リフレクタ集積化のための薄いAuキャップ層を用いた大気中常温接合 ○日暮栄治, 國宗豊, 須賀唯知(東京大学) 4. リフローはんだ付におけるフラックスと酸腐蝕環境の比較 ○何思亮, 西川宏(大阪大学) 5. Ni密着層とCuNi合金ナノ粒子添加による無加圧Cu微粒子焼結接合の高強度化 ○石崎敏孝, 渡邊亮太, 日井正則, 佐藤敏一, 明渡邦夫(豊田中央研究所) 6. 表面活性化接合法に基づいたSiO ₂ ウエハ接合 ○母風文 ¹ , 藤野典久 ¹ , 須賀唯知 ¹ , 井口研一 ² , 中澤治雄 ² , 高橋良和 ² (¹ 東京大学, ² 富士電機)	【1D1】ものづくりセッション 1. 高温観察装置による酸腐蝕環境下のはんだ溶融比較 ○西室将(山陽精工) 2. 実環境を想定した高圧蒸気洗浄噴射試験(IPX9K)による耐水性能とその考察 ○横浩之, 戸井恵子, 梁井誠, 青木雄一(エスベック) 3. 3次元電気CAD『CR-8000 Design Force』による次世代実装技術への取り組み ○長谷川清久 ¹ , 松澤浩彦 ¹ , 福岡梯 ² (¹ 図研, ² ジェイサス) 4. ラマン分光法による実デバイス局所歪評価法の開発 ○内田智之, 小坂賢一, 杉江隆一, 伊藤元剛(東レリサーチセンター) 5. 一方熱流定常比較法による熱伝導率測定装置の開発 ○豊泉崇, 山本裕美, 川本裕二, 宝泉俊寛(レスカ) 6. 電子機器実装用低温・短時間硬化接着剤 ○徳平英士, 北村和夫, 八木久夫, 伊達仁昭(富士通クリティカル) 7. 超微細回路形成に適した表面処理プロセス トップUPFプロセス ○津野勇輝, 村田俊也, 妻俊行(奥野製薬工業) 8. 急成長を遂げるFO-WLPにおけるスパッタリング工程の高生産性への解 ○中尾正樹 ¹ , Chris Jones ² (¹ SPPテクノロジー, ² SPTS Technologies)
11:50	【1A2】パワーエレクトロニクス-2 1. 車載用パワーモジュールのはんだ接合部信頼性設計 ○樋口晋吾 ¹ , 林敬昌 ¹ , 坂本善次 ¹ , 岡田咲枝 ² (¹ デンソー, ² 千住金属工業) 2. Cu/Snペーストを用いた高温動作パワーモジュール向け低温・低加圧接合技術 ○郎豊群 ¹ , 加藤史樹 ¹ , 仲川博 ¹ , 山口浩 ¹ , 佐藤弘 ¹ , 池田博明 ² , 木村竜司 ² , 岡田圭二 ² , 下川耕一 ² , 関根重信 ² (¹ 産業技術総合研究所, ² ナブテック) 3. 車載向けSn-Cu系はんだ/電解Ni界面エレクトロマイグレーションに及ぼすSn結晶方位の影響 ○酒井翼 ¹ , 瀬井翼 ¹ , 武直矢 ² , 門口卓矢 ² , 野口真男 ² , 山中公博 ¹ (¹ 中京大学, ² トヨタ自動車) 4. 車載向けCu/Ni/Sn-0.7Cu接合部エレクトロマイグレーション起因の故障モード解析 ○瀬井翼 ¹ , 酒井翼 ¹ , 武直矢 ² , 門口卓矢 ² , 野口真男 ² , 山中公博 ¹ (¹ 中京大学, ² トヨタ自動車) 5. 高放熱Pbフリーダイアタッチ材を用いたパワーデバイス用パッケージ開発 ○作元祥太郎, 中村卓, 中村慎吾, 岩崎俊寛(ジェイデバイス)	【1B2】表面処理・めっき技術-2 1. 細胞接着・伸展性向上のための金属材料表面処理 ○小林千悟(愛媛大学) (依頼講演 40分) 2. SiCへの直接無電解めっき ○山田直輝 ¹ , 福田健二 ¹ , 阪本進 ² , 福室直樹 ¹ , 八重真治 ¹ (¹ 兵庫県立大学, ² 日本イオコス) 3. ケミカルダイシングの実現に向けたMetal Assisted Chemical Etching反応機構の研究 ○松尾圭一郎 ¹ , 土持廣彬 ² , 樋口和人 ¹ , 下川一生 ¹ , 佐藤強 ¹ , 中村功 ³ , 藤谷忠博 ³ (¹ 東芝, ² 芝浦メカトロニクス, ³ 産業技術総合研究所) 4. Nd:YVO ₄ グリーンレーザを用いた熱硬化性樹脂基板への銅厚膜配線形成 ○園田久也 ^{1,2} , 足立修二 ² , 御田護 ³ , 山崎和彦 ¹ , 前川克廣 ¹ (¹ 茨城大学, ² アルファジャパン, ³ M&M研究所)	【1C2】新規接合材料 1. ビーザム金属間化合物(IMC)分散鉛フリーはんだ接合による高信頼性化検討 ○中田裕輔 ¹ , 倉澤元樹 ¹ , 橋本富仁 ¹ , 林和 ² , 莊司郁夫 ¹ (¹ カルソニックカンセイ, ² 群馬大学) 2. ソルダフィラー含有ハイブリッド樹脂実装におけるポイド形成 ○福本信次, 藪田康平, 松嶋道也, 藤本公三(大阪大学) 3. 銅フィラー導電性接着剤の低融点金属含有による特性向上 ○松嶋道也, 武知裕輔, 溝上陽介, 福本信次, 藤本公三(大阪大学) 4. 銅系導電性接着剤の電気伝導特性に及ぼすフィラー表面処理効果のバインダ選択性 ○井上雅博, 瓦井健太, 多田泰徳(群馬大学) (~14:00)	【1D2】高速高周波・電磁特性技術 1. デザイン改善によるビルドアップ基板の伝送特性向上 ○斉藤聡義 ¹ , 緑川健 ² (¹ 富士通アドバンステクノロジー, ² 富士通インターコネクトテクノロジー) 2. 床面に配置された電極を利用する人体通信 - 電極上の立ち位置に対する伝送特性および電界分布 - ○藤田佑輔 ¹ , 越地福朗 ¹ , 越地耕二 ² (¹ 東京工芸大学, ² 東京理科大学) 3. 三組の不均衡ダイポールアンテナをY字に配置した3次元形状の広帯域アンテナ ○山田智裕 ¹ , 越地福朗 ¹ , 越地耕二 ² (¹ 東京工芸大学, ² 東京理科大学) 4. 磁界共振結合を利用する近距離ワイヤレス通信 - 位置ずれ時の伝送特性と磁界分布の検討 - ○山口諒也 ¹ , 越地福朗 ¹ , 越地耕二 ² (¹ 東京工芸大学, ² 東京理科大学) 5. 水中環境における人体通信の検討 ○小野健太 ¹ , 藤田佑輔 ¹ , 越地福朗 ¹ , 越地耕二 ² (¹ 東京工芸大学, ² 東京理科大学)
12:40				
14:00	(~14:20)	(~14:20)		(~14:20)
14:00	ものづくりコアタイム			
15:00				

1号館 3階 清明ホール		
15:00	MES2015表彰式	A会場:1号館 3階 清明ホール B会場:1号館 3階 133 C会場:1号館 3階 132 D会場:1号館 3階 131 ものづくり展示コーナー:1号館 3階 13A, B 受付:1号館 エントランス
15:20	招待講演	
16:20	1. 両面放熱パワーモジュールの開発と車載半導体製品の実装技術 平野尚彦氏(デンソー)	
16:20	招待講演	
17:20	2. 人工知能・集団知能とロボット ~ガンダムの作り方 ビトヨ ハルトノ氏(中京大学)	

17:50	交流会
19:50	会場:2号館 アレーナ211



MES2016 プログラム				9月9日(金)			
A会場		B会場		C会場		D会場	
9:00	【2A1】ミッションフェローセッション 異分野への挑戦 ~今、変わる時~ 1. 今どきの自転車 ○嶋嶋敬(シマノ) (9:40~10:20)	【2B1】表面処理・めっき技術-3 1. 有機溶媒陽極酸化による可視応答性光触媒被膜形成-抗菌材料への応用- ○大津直史(北見工業大学) (依頼講演 40分) 2. 電気化学的手法によるSn系Naイオン二次電池用負極材の作製 ○岡本尚樹, 守田昂輝, 齊藤文靖(大阪府立大学) 3. 電析法を用いた硫化物半導体の作製と電気化学測定による反応機構の考察 ○岡本尚樹, 片岡健太郎, 齊藤文靖(大阪府立大学)	【2C1】プリンタブルエレクトロニクス-1 1. 全方向インクジェット(OIJ)印刷技術による立体物両面エッジ乗り越え大電流配線形成 ○吉田泰則, 泉小波, 時任静士(山形大学) 2. ニードル式ディスペンサを用いた評価用パターンの描画による少量での銀ナノインクの特性評価 ○柏木行康 ¹ , 齊藤大志 ¹ , 長谷川貴洋 ¹ , 垣内宏之 ² , 青柳伸宜 ³ , 吉田幸雄 ² , 千金正也 ¹ , 中許昌美 ¹ (¹ 大阪府立工業研究所, ² 大研化学工業) 3. Agナノインクの印刷により形成したAg/n-GaN ショットキー接合の評価 ○塩島謙次 ¹ , 重宗翼 ² , 小泉洋 ² , 児島貴徳 ² , 柏木行康 ¹ , 齊藤大志 ¹ , 長谷川貴洋 ¹ , 千金正也 ³ , 藤原康文 ² (¹ 福井大学, ² 大阪大学, ³ 大阪府立工業研究所) 4. ピコパルスレーザを用いたプリンタブルエレクトロニクス用シームレスマイクロパターンロール作製技術 ○石橋健太郎, 加藤英則, 谷垣昇吾, 竹内将人, 篠原秀敏, 本間周平, 福山聡(東芝機械)	【2D1】最先端材料-1 1. 長鎖脂肪族ユニットを持つポリチオールで変性した高耐熱性・強靱性ビスマレimid樹脂 ○大塚恵子 ¹ , 木村篤 ¹ , 米川盛生 ¹ , 池下真二 ² , 中尾日六士 ² , 宮田篤 ² (¹ 大阪府立工業研究所, ² 堺化学工業) 2. 球状多孔質ヒドロキシアパタイトとチタニア複合材料の合成とメチレンブルーの分解能評価 ○玉澤健吾, 吉島成美, 小平直信, 野浪亨(中京大学) 3. 実装基板コーティング材の放熱性への受熱面放射率の影響 ○伊藤真紀, 石井利昭(日立製作所) 4. ローターキルンで作製した竹炭による水溶液中のセシウム・ストロンチウムの吸着特性 ○早川慎吾 ¹ , 福盛啓師 ¹ , 松原裕一郎 ¹ , 鷺見佑介 ¹ , 山本翔 ¹ , 河村典久 ² , 野浪亨 ¹ (¹ 中京大学, ² 金城学院大学)			
10:20							
10:30	2. 知財を駆使して技術開発を行い事業競争力を得る ~知財戦略のセオリーについて~ ○鮫島正洋(内田・鮫島法律事務所) (10:20~11:00) 3. 大手/中小企業がDMM.make AKIBAやIoTスタートアップとのコラボレーションによってどのような可能性が生まれるのか ○岡島康憲(DMM.com) (11:00~11:40) 4. パネルディスカッション (11:40~12:10)	【2B2】カーエレクトロニクス 1. 車載電子製品の実装技術動向 ○神谷有弘(デンソー) (依頼講演 40分) 2. 車載用傾斜ルーバ管式ヒートパイプヒートシンクの開発 ○大串哲朗 ¹ , 山崎久明 ² , 竹市剛志 ³ (¹ アドバンスドナレッジ研究所, ² 山崎技術士事務所, ³ 悠高) 3. 車載エンジン環境におけるCuワイヤボンディング技術-パッケージ応力の影響- ○藤井啓永, 宮脇正太郎, 浅井康富, 荒木誠, 浅井昭喜(デンソー) 4. 車載エンジン環境におけるCuワイヤボンディング技術-封止樹脂中の腐食成分低減- ○國枝佳一 ¹ , 宮脇正太郎 ¹ , 荒木誠 ¹ , 松尾誠 ² (¹ デンソー, ² 住友ベークライト)	【2C2】プリンタブルエレクトロニクス-2 1. 受理特性に優れたソフトブランケットグラビア(SBG)印刷技術 ○泉小波, 吉田泰則, 時任静士(山形大学) 2. ソフトブランケットグラビア(SBG)印刷技術による線幅が異なる銀配線の同時印刷 ○中村裕之, 吉田泰則, 泉小波, 熊木大介, 時任静士(山形大学) 3. エッチング工程を必要としない環境配慮型プリント配線基板製造工法の開発(2) ○加藤義尚 ¹ , 北田真也 ² , 本田耕二 ² , 鈴木治行 ² , 加東隆 ³ , 山口範博 ⁴ , 寺田恒彦 ⁴ , 太田茂男 ⁵ , 酒井善夫 ⁵ , 友景隆 ¹ (¹ 福岡大学, ² アサダメッシュ, ³ 奥野製薬工業, ⁴ タツタ電線, ⁵ 互応化学工業) 4. 銅ナノインクによる有機フィルム上での導電パターンの形成 ○南原聡, 川戸祐一, 濱野翼, 有村英俊(石原ケミカル) 5. 機械的変形に伴う伸縮性印刷配線の電気伝導特性変化の動的解析 ○井上雅博, 細野雄太, 多田泰徳(群馬大学)	【2D2】最先端材料-2 1. 薄いAu薄膜を用いたAl合金とステンレス合金の大気中の室温接合 ○魚本幸, 阿部真帆, 島津武仁(東北大学) 2. 薄いAu薄膜を用いたAl合金とCuの大気中の室温接合 ○阿部真帆, 魚本幸, 島津武仁(東北大学) 3. 異なる粒径を有するAgフィラーを分散させた導電性接着剤のパーコレーション転移挙動解析 ○飯田将基, 多田泰徳, 井上雅博(群馬大学) 4. X線光化学反応による金属ナノ・マイクロ粒子生成 ○山口明啓 ¹ , 岡田育夫 ² , 福岡隆夫 ¹ , 内海裕一 ¹ (¹ 兵庫県立大学, ² 名古屋大学) 5. 銀ナノ粒子をめっき下地とした銅めっき膜とポリフェニレンスルフィド基材(PPS)間の密着性評価 ○富土川直, 村川昭, 深澤憲正, 白髪潤, 島屋卓, 森耕太郎(DIC)			
12:10							
13:00	【2A2】パワーエレクトロニクス-3 1. パワー半導体の高温動作を可能にするアセンブリ技術 ○藤野純司, 坂元創一, 柳本辰則, 巽裕章, 増森俊二(三菱電機) (依頼講演 40分) 2. 2層活性金属銅回路セラミック基板構造による高速・高温動作SiCパワーモジュール ○孝井健一 ^{1,2} , 村上善則 ³ , 佐藤伸二 ^{1,4} , 谷澤秀和 ^{1,4} , 高橋弘樹 ^{1,5} , 加藤史樹 ¹ , 渡辺友世 ¹ , 佐藤弘 ¹ (¹ 産業技術総合研究所, ² カルソニックカンセイ, ³ 日産自動車, ⁴ サンケン電気, ⁵ 富士電機) 3. 大容量IGBTモジュール向けAIN基板を適用した高信頼性パッケージ技術 ○玉井雄大, 百瀬文彦, 尾尾章, 齊藤隆, 能川玄之, 西村芳孝, 望月英司, 高橋良和(富士電機) 4. GaN-HEMT実装基板が持つ寄生因子解析 ○貝沼雄太, 大塚晃晃, 田口博久, 山中公博(中京大学)	【2B3】信頼性技術 1. Air-HASTを用いたはんだフラックス由来のBrによるAu-Al接合部の腐食に関する耐湿加速評価 ○西原麻友子, 井上紘子(村田製作所) 2. パワーデバイスにおける封止樹脂と基板のはく離強度評価 ○池田徹 ¹ , 井上航太郎 ¹ , 小倉正明 ¹ , 畑尾卓也 ² , 中井戸宙 ² (¹ 鹿児島大学, ² 住友ベークライト) 3. 構造因子を考慮した高密度配線板用スルーホールめっき膜の熱疲労寿命予測の検討 ○渡邊和典 ¹ , 菊谷義治 ¹ , 広島義之 ² , 菊池俊一 ² , 松井亜紀子 ² , 清水浩 ³ (¹ 芝浦工業大学, ² 富士通アドバンストテクノロジー, ³ 日立化成) 4. 高耐熱実装のためのSiC表面電極の検討 ○関伸弥, 下山肇夫, 張昊, 村松哲郎, 菅原徹, 長尾至成, 菅沼克昭(大阪大学) 5. 純SnとSUS304, SUS316の腐食挙動の比較 ○三木健司 ¹ , 黒瀬雅詞 ¹ , 南口誠 ² , 山内啓 ¹ (¹ 群馬工業高等専門学校, ² 長岡技術科学大学)	【2C3】3次元実装・先端パッケージ-1 1. 3次元LSI実装の微細マイクロハンパ接合状態と電流密度耐性 ○只木進二, 山崎一寿, 赤松俊哉, 酒井泰治, 北田秀樹, 山誠樹, 中田達己(富士通) 2. 永久膜レジストマスクとInjection Molded Solder (IMS)法を用いた低コストハンピング手法 ○中村英司 ¹ , 青木豊広 ¹ , 山田靖治 ¹ , 久田隆史 ¹ , 森谷幸 ¹ , 高橋誠一郎 ² , 武川純 ² , 小畑知弘 ² , 大喜多健三 ² , 長谷川公一 ² (¹ 日本アイ・ピー) 3. 複合表面活性化法によるCu/Dielectricハイブリッド接合 ○赫然(HerAn) ¹ , 藤野真久 ¹ , 山内朗 ² , 須賀唯知 ¹ (¹ 東京大学, ² ボンドテック) 4. TSVの応力の影響によるCMOS回路レベルのKOZの抽出 ○田代浩子, 宮原昭一, 北田秀樹, 石塚剛, 作山誠樹(富士通)	【2D3】計測・検査技術-1 1. ビッグデータビジネス検証用センサモジュール搭載システムの開発 ○島内岳明 ¹ , 勝木隆史 ¹ , 豊田治 ¹ , 稲越宏弥 ¹ , 村上滋春 ² , 鈴木規之 ² (¹ 富士通研究所, ² 富士通) 2. 外乱予測に基づくテンプレート更新機能を有する進化型画像マッチング手法 ○篠原伸之, 大野広輝, 橋本学(中京大学) 3. 多次元空間におけるManifold表現に基づく回転テンプレートマッチングの高速化手法 ○奥川純太, 大野広輝, 橋本学(中京大学) 4. サブサーフェス磁気イメージング法を用いたインダクタの電流経路映像化 ○鈴木章吾 ¹ , 稲垣明里 ¹ , 美馬勇輝 ¹ , 木村憲明 ^{2,3} , 木村建次郎 ^{1,3} (¹ 神戸大学, ² Integral Geometry Science, ³ JST先端計測) 5. 検査員の印象表現に基づいた欠陥分類 ○片山隼多 ¹ , 大塚慧介 ¹ , 丹下幹仁 ¹ , 吉村裕一郎 ¹ , 青木公也 ¹ , 舟橋琢磨 ¹ , 奥水大和 ¹ , 加藤久幸 ² , 池野純 ² , 山村良太 ² , 小口幸成 ² , 福澤満保 ² (¹ 中京大学, ² YKK)			
14:40	ものづくりコアタイム						
14:40	ものづくりコアタイム						
15:10	ものづくりコアタイム						
15:10	【2A3】パワーエレクトロニクス-4 1. Agナノ粒子焼結体のクリープ変形機構の検討 ○塩田竜太郎, 菊谷義治(芝浦工業大学) 2. ナノAg接合における接合界面応力制御と高温信頼性 ○趙力, 亀井一人, 田中康紀, 飯塚智徳, 巽宏平(早稲田大学) 3. 次世代半導体パワーデバイスの量産化に向けた焼結接合装置の開発と検証 ○下山肇夫, 張昊, 関伸弥, 村松哲郎, 菅原徹, 長尾至成, 菅沼克昭(大阪大学) 4. 無加圧接合用焼結Cuダイボンド材料の開発(I)-初期接合性評価- ○石川大, 川名祐貴, 須藤千絵, 中子偉夫, 江尻芳則, 蔵潤和彦(日立化成) 5. 無加圧接合用焼結Cuダイボンド材料の開発(II)-パワーデバイスへの適用とその熱特性- ○須藤千絵, 川名祐貴, 石川大, 中子偉夫, 江尻芳則, 蔵潤和彦(日立化成)	【2B4】バイオマテリアル 1. マイクロメカトロニクスを活用したバイオ計測・操作と応用 ○新井史人(名古屋大学) (依頼講演 40分) 2. 自己復元性インタフェース材料のための生体接着表面の創出 ○安田清和(大阪大学) 3. 呼吸中アンモニア濃度のリアルタイム測定が可能な高感度センサーデバイスの開発 ○百瀬悟, 柄澤一明, 玉込道雄, 高須良三, 並井修(富士通研究所) 4. 生体親和性エレクトロニクス実装のための低温大気圧接合技術 ○重藤暁津 ¹ , 付偉欣 ² , 水野潤 ² , 庄子晋一 ² (¹ 物質・材料研究機構, ² 早稲田大学)	【2C4】3次元実装・先端パッケージ-2 1. TSV/バリアード層の無電解めっき形成及びCu ₁ 拡散バリア性評価 ○平手博史, 宮地悠人, 太田晃平, 伊藤健, 清水智弘, 新宮原正三(関西大学) 2. ピアスト/TSVプロセスで形成した微細TSVの電気特性評価 ○渡辺直也 ¹ , 菊地秀和 ² , 柳澤あづさ ² , 島本晴夫 ¹ , 菊地克弥 ¹ , 青柳昌宏 ¹ , 中村彰男 ² (¹ 産業技術総合研究所, ² ラピセミコンダクタ) 3. フィルム材料を用いた大判パネルFan-outパッケージ作製 ○高橋宏, 乃乃裕一, 竹越正明, 鈴木直也, 高野希, 野中敏夫(日立化成)	【2D4】計測・検査技術-2 1. 濃淡画像情報の共起特徴を用いた小型電子部品コネクタの欠陥検出 ○舟橋琢磨, 野村真希, 武藤功樹, 奥水大和(中京大学) 2. 高耐熱封止樹脂の密着強度試験におけるはく離挙動と熱応力影響の解析 ○平田誠磨, 澁谷忠弘, 坂本博司(横浜国立大学) 3. 顕微ラマンイメージングによる高温領域のSiC基板表面の熱応力分布に関する研究 ○松尾信裕, 伊奥田大輝, 須田潤(中京大学) 4. ロックイン発熱解析(LIT)を用いた実装基板の解析手法 ○今井康雄 ¹ , 坪井克昌 ¹ , 味岡恒夫 ¹ , 山本剣 ¹ , 高森主 ¹ , 太田直人 ² (¹ 沖エンジニアリング, ² 日本サイエンティフィック)			
16:50							